

2016 하반기 LG전자 신입사원 정시채용

● 지원 자격

- 대상** 2017년 2월 졸업 예정자 및 기졸업자 (학사/석사/박사)
- 학위** 국내/해외에서 학사/석사/박사 또는 이와 동등한 효력이 인정되는 자격을 취득(예정)한 자
- 학점** 전학년 평점 기준 : 3.0/4.5 이상 (최종학위 기준)
- 병역** 군필자 또는 면제자에 한함
- 어학** 자사 기준에 준하는 공인 영어 성적 보유자 (서류 접수 마감일 기준 2년 이내 유효 성적에 한함, 단 영어권 국가의 4년제 해외대 학위 취득자는 어학 성적 제출 대상에서 제외)

해당 직무	TOEIC	TOEIC Speaking	OPic
Sales, Finance	700이상	Level 6 이상	IM 이상

※ OPIC 등급 중 IM 등급은 IM1, IM2, IM3으로 나누어 입력함

※ 상기 직무 외에는 어학 점수를 입력하여도 서류전형에 반영되지 않습니다. 단, 면접 대상자에 한하여 별도 어학 성적을 요청 또는 자체 어학 Test를 실시할 예정입니다.

기타

- 해외 여행에 결격 사유가 없는 경우에 한함
- 산학장학생은 별도 모집 프로그램으로 선발함
- 입사지원서 및 채용 전형 과정에서 허위 사실이 발각될 경우는 입사가 취소될 수 있음
- 졸업예정자의 경우 입사 후 3개월 내 학위증명서를 제출하지 못할 시 입사가 취소될 수 있음
- 취업 보호 대상자(보훈 대상자/장애인)는 관련 법규 등에 의거하여 우대함
※ 면접 또는 최종 합격시 해당 증명서 제출자에 한함

● 일정 및 프로세스



1차 서류 전형 입사지원서를 기준으로 지원 분야에 해당하는 필요 역량을 갖추었는지를 판단

인/적성 검사 LG Way 와의 적합성 확인 및 언어/수리 등 기본 역량 평가

구분	검사 내용	문항 수	소요 시간
인성검사 (LG Way Fit Test)	지원자와 LG Way 간의 적합성 확인	342문항	50분
적성 검사*	언어이해/ 언어추리/ 인문역량/ 수리력/ 도형추리/ 도식적추리	125문항	140분

* 문항예제는 Careers.lg.com에서 확인할 수 있습니다.

직무지필시험 기본적인 직무 능력을 갖추었는지를 평가

직무	검사 내용	문항 수	소요 시간	응시일
R&D_SW	C, JAVA 프로그래밍 관련	70 문항	110분	인/적성 검사일
R&D_HW	전기공학, 전자공학	80문항	100분	인/적성 검사일
R&D_기구	기계공학	40문항	50분	인/적성 검사일
Finance	기초회계 관련	20문항	60분	인/적성 검사일

면접 전형 직무별 다양한 모듈을 통해 지원자의 직무/인성을 종합적으로 평가

구분	검사 내용
직무 면접	직무 지식 및 직무 적합도 검증
인성 면접	LG Way 형 인재 검증

LG Electronics Recruiting

◆ 지원 분야

본부	직무	주요 업무 / 역할	관련전공						근무지
			전기/전자	기계	컴퓨터/SW	소재/재료	경영/경제	기타 전공	
H&A사업본부 (Home appliance & Air solution)	R&D_기구	· 열 유체 유동설계, 구조 설계, 해석 (응용역학, CAD/CAE/CAM, 최적설계) · 강성, 동역학, 피로해석, 진동/소음 분석 및 평가 등		●					서울/창원
MC사업본부 (Mobile Communications)	R&D_HW	· 무선 통신 기술 (LTE · LTE-A / Wifi / Bluetooth 관련 RF, Antenna 설계) · 시스템 회로 설계 등	●						서울/평택
	R&D_기구	· 구조 설계, 제품 외관 기술 등		●					
HE사업본부 (Home Entertainment)	R&D_SW	· Embedded Linux, Framework, Application, SDK, Transcoding · 네트워크, Device Driver Control 등	●		●				서울/평택
	R&D_HW	· 회로설계, 개발기획, SoC전략수립, Power설계 등	●						
	R&D_기구	· 구조해석, 방열해석, 구조분석, 외관소재, 광학설계, CMF, 회로해석 등		●					
VC사업본부 (Vehicle Components)	R&D_SW	· Application, Connectivity, OS, Test Manager, ASIC/FPGA, Touch/HMI 알고리즘 · Machine vision, 인식/학습 알고리즘, 무선 Protocol, RF Design, 제어 S/W 등	●		●				서울/인천/평택
	R&D_HW	· 회로개발, Radio Tuning, H/W 시스템, EMC/EMI 설계, LCD/OLED 회로/Interface 등	●						
	R&D_기구	· 고전압 대용량 인버터/컨버터 기구 설계 및 제작, 모터 개발 · 배터리 모듈/팩 기구 설계 및 제작, 열관리 시스템 설계, Drive Unit 구조 설계 등		●				● (자동차)	
CTO (Chief Technology Officer)	R&D_SW	· Application, Middleware, Network, OS Kernel, SW Engineering, Platform 등	●		●				서울
	R&D_HW	· Analog/Digital Circuit Design, CMOS Integrated Circuit, Electric Machinery · Micro & Nano Device, Optics, Power Electronics, SoC Design, 센서제어 등	●						
	R&D_기구	· 유체 제어기술, Aeroacoustics, Fan&Flow설계 · 열교환기, 감성진동소음, 구조진동/회전, Structural Dynamics, Thermal Dynamics 등		●					
생산기술원 (Production engineering Research Institute)	R&D_SW	· 장비운영 SW, 제어 알고리즘 개발, 영상처리 SW, Machine Vision	●		●				평택/구미
	R&D_HW	· 영상처리, 고속 회로, 파워, 회로설계 등	●						
	R&D_기구	· 장비설계, Layout 설계, 정밀 구동부/강성 구조설계, 광학 모듈 설계 · 구조/충격/강성 해석 및 최적 설계, 열유동/진동소음 설계 및 해석		●					
	R&D_Production	· 생산시스템 설계/검증, 생산전략 수립/계획 최적화, 제품 Architecture 표준 설계/개발 · 금속/글라스 가공 기술, 플라스틱 및 복합소재 개발/응용, CMF 기술				●		● (산업공학)	
소재기술원 (Materials & Devices Advanced Research Institute)	R&D_Material&Device	· 센서, 복합 신소재, 에너지-환경, 광학, 차세대 디스플레이 · 나노 소재, 물성분석, 방열, 단열 소재 개발 등	●			●		● (이공계)	서울
Solar BD (Solar Business Division)	R&D_HW	· Solar 시스템개발 R&D로 Micro Inverter 개발 및 시스템 Application 등	●						서울/구미
	R&D_Material&Device	· Solar cell & Module 재료 및 공정기술, Si기반 반도체 공정 등				●			
CFO (Chief Finance Officer)	Finance	· 회계, 금융, 세무, 통상, IR, M&A, MIS, 경영관리, 기획관리, 보험 등					●		서울/인천/평택/창원
한국영업본부	Sales	· 가전(B2B,B2C) 및 모바일 제품군의 온라인, 오프라인 유통채널 관리 · 사이너지, 솔라, 솔루션 등 신사업 제품군의 기술 제안영업 * 기계, 컴퓨터/SW, 전기/전자, 건축학과 전공자 우대	●	●	●	●	●	● (전공 무관)	전국

※ CTO, 소재기술원 및 H&A사업본부 서울사업장은 석사 이상만 지원 가능
 ※ 해외영업직군은 한국영업본부에서 일정 기간 근무한 인원 중 우수인원을 선발하여 배치함
 ※ 당사 채용계획에 따라 본인이 지원하지 않은 본부/직무로 검토될 수 있음

*상기 내용은 당사 채용 설명회를 위한 자료이므로, 당사의 허락을 받지 않은 전체 또는 일부 자료에 대한 무단복제 및 재배포 등을 금합니다.